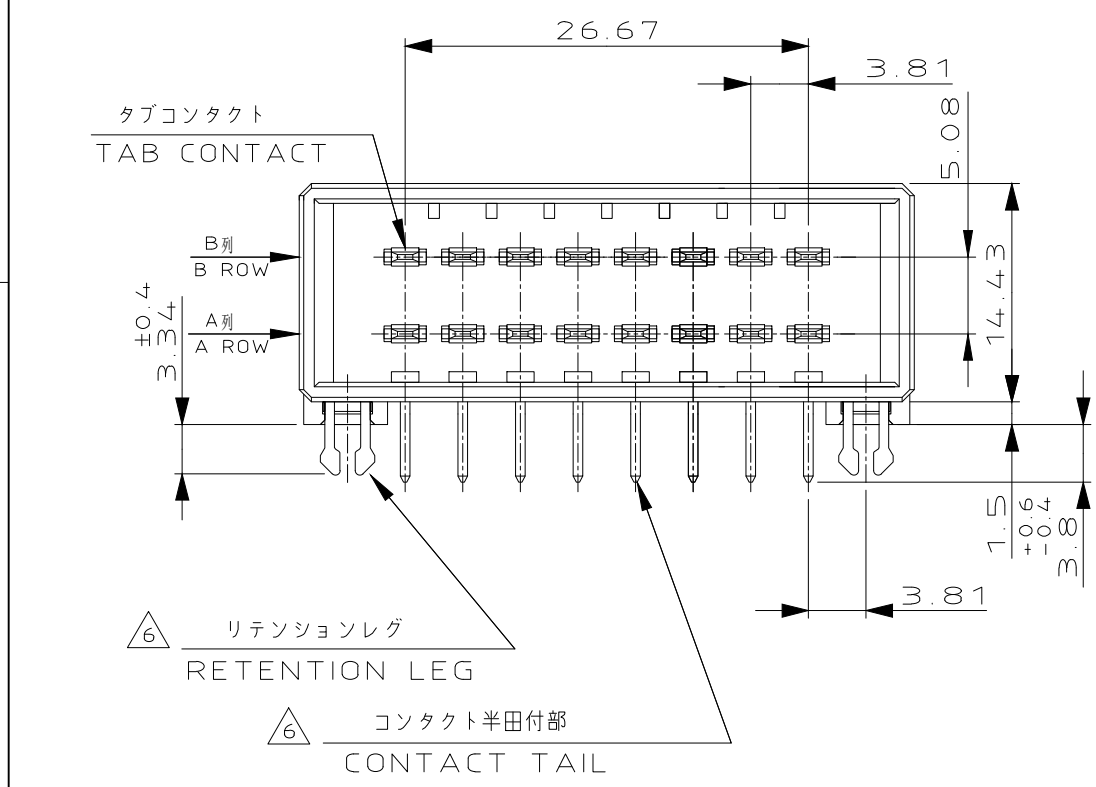
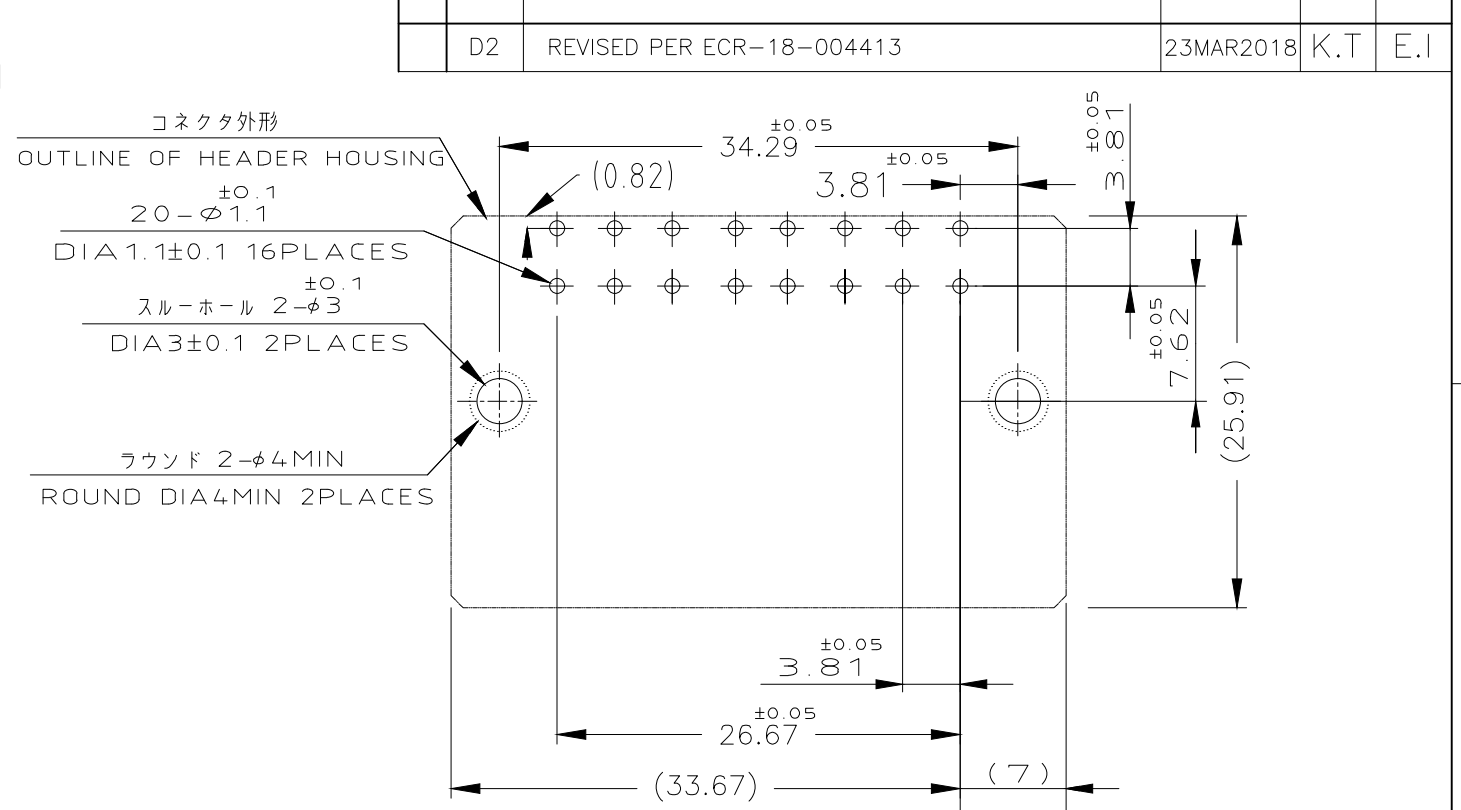
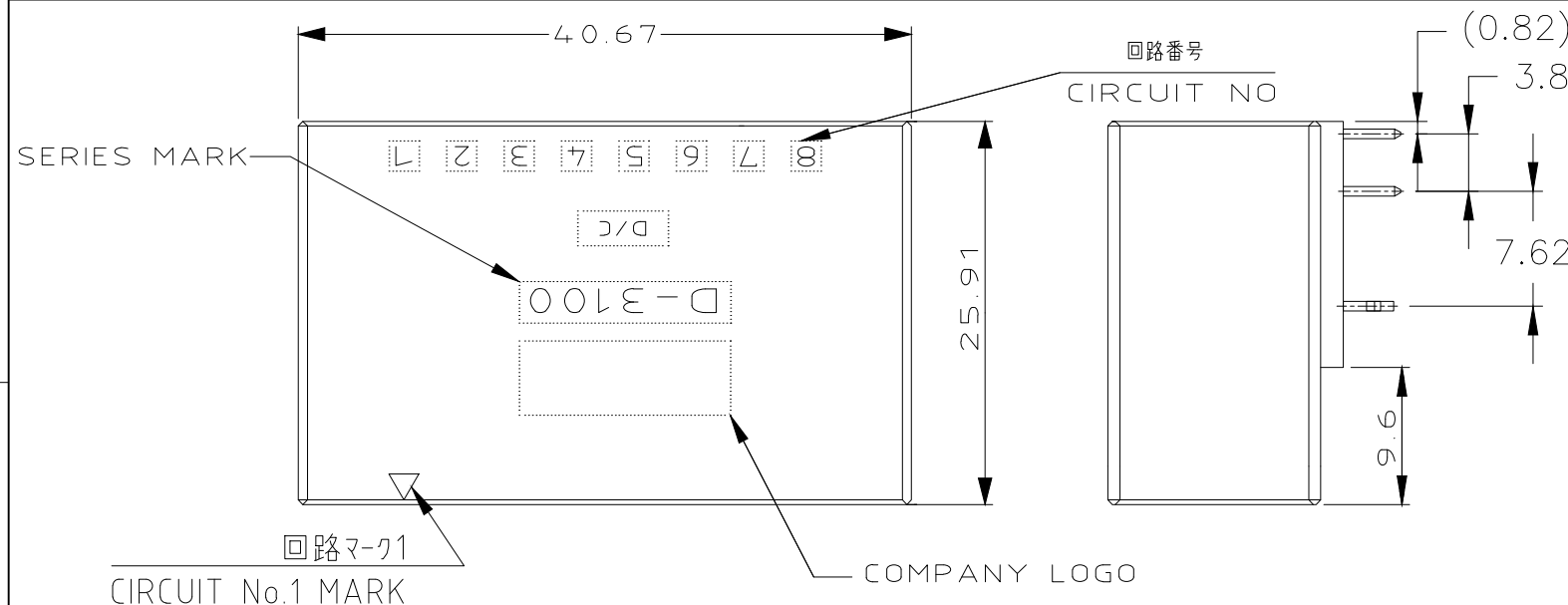


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - Tyco Electronics JAPAN G.K. ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D2	REVISED PER ECR-18-004413	23MAR2018	K.T	E.I



推奨基板取付け穴寸法  
 PC 基板厚: 1.6±0.1 (非累積公差) (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE) (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- GENERAL TOLERANCE  
 10 ≥ : ±0.3  
 30 ≥ > 10 : ±0.4  
 100 ≥ > 30 : ±0.45  
 ANGLE : ±3°

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒  
 コンタクト: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき
- 一般公差  
 10 ≥ : ±0.3  
 30 ≥ > 10 : ±0.4  
 100 ≥ > 30 : ±0.45  
 角度 : ±3°

△6	△2	178307-6
△6	△4	178307-5
△6	△3	178307-3
△6	△2	178307-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.IKEDA 16.MAR.95	TE Connectivity Ltd.		
		CHK S.Manabe 23.MAR.95			
DIMENSIONS: mm		APVD K.Ikeda 13.MAR.95	NAME		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.		PRODUCT SPEC	16 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASSY FOR DYNAMIC 3100		
		APPLICATION SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO		
MATERIAL SEE NOTE		WEIGHT	A3 00779 C=178307		
FINISH SEE NOTE		CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1
				REV D2	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)